DIVA Labs.

# ECR (Engineering Change Request)



ok

| | | |
|---|---|---|
| **Proposed Change：** | ☐1. Design modification 設計修改 ☐2. Material change 材料變更 ☐3. Manufacturer change 製造商變更<br>☐4. Factory change 工廠變更 ☐5. Process sequency change 工序變更 ☐6. Equipment / Tooling change 設備/ 模具變更<br>☐7. Process / Method / Condition change 加工流程/方法/條件變更 ■8.Add second source 新增替代料<br>☐9. Others 其他：_____ | **Initiator** ： Tony 1205 1130 |
| **Reason for Change：** | EPIQ product series - Main BD、Badge BD、MIC BD Connector add second source & Badge BD PCBA add second source. | **EC No**：EC25120101 |
| **Model / Part No.：** | EPIQ-Premium、EPIQ-AUO、EPIQ-AUO (SUZHOU)、VM14 | **Issue Date**：2025/12/1<br>**Requester Dept.**：DV11M009 |
| **Implementation Type：** | ☐1. Immediately Change 立即切換 ■2. Running Change 自然切換 ☐3. Other 其他：_____ | **Customer Approval**：（confirmed by PM） ☐Needed ■Not needed |

**Material Change Description**（Please add pages as needed if the provided space is insufficient.）
**物料變更說明（如不敷使用請逕行增頁）**

| No. | Subassembly | | Part No. | Description | Q'ty | Location | Stock | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ 2AAD539R038<br>✓ 2AAD539R138 | B | | | | | | 1st:3FM00218310<br>2nd:3FM00217510<br>Del:3FM00200110 |
| | | A | 3FM00218310 | CONN.M (S1315-02RWA-S03-KQDH,XINYA) | 2 | CN504,CN505 | 0 | |
| 2 | ✓ 2AAD539R038<br>✓ 2AAD539R138 | B | | | | | | 1st:3FM00318310<br>2nd:3FM00317510<br>Del:3FM00300110 |
| | | A | 3FM00318310 | CONN.M (S1315-03RWA-S03-KQDH,XINYA) | 1 | CN503 | 0 | |
| 3 | ✓ 2AAD539R038<br>✓ 2AAD539R138 | B | | | | | | 1st:3FM00418310<br>2nd:3FM00417510<br>Del:3FM00400110 |
| | | A | 3FM00418310 | CONN.M (S1315-04RWA-S03-KQDH,XINYA) | 1 | CN502 | 0 | |

**Comments 會簽意見**

| R&D | | Department 會簽部門 | | | | | | | | Approval |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Initiator | Initiator's Direct Supervisor | DQE | PM | Sales | PE | PMC | SCM | PD | QA | R&D Director |
| Tony 1201 1700 | Michael 1202 0915 1202 0910 | [illegible] 1202 1910 | [illegible] 1202 | Estela 1202 0925 | [illegible] 1202 1040 1202 Hanan 1310 | Terry 1203 1400 [illegible] 1203 | Miy 12/3 | Bowen 1203 0880 Joanne 1202 1555 | [illegible] 1203 1203 1715 | Michael 1206 1630 |

# ECR (Engineering Change Request)



**Material Change Description** ( Please add pagesor row as needed if the provided space is insufficient. )
物料變更說明（如不敷使用請逕行增頁或增列）

| No. | Subassembly | | Part No. | Description | Q'ty | Location | Stock | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2AAD539R03J ~~2AAD539R13J~~ | B | | | | | | 1st:3FM00318310<br>2nd:3FM00317510<br>Del:3FM00300110 |
| | | A | 3FM00318310 | CONN.M (S1315-03RWA-S03-KQDH,XINYA) | 1 | CN1 | 0 | |
| 5 | 2AAD539R23J | B | | | | | | 1st:3FM00318310<br>2nd:3FM00317510 |
| | | A | 3FM00318310 | CONN.M (S1315-03RWA-S03-KQDH,XINYA) | 1 | CN1 | 0 | |
| 6 | 2AAD539R03H | B | | | | | | 1st:3FM00418310<br>2nd:3FM00417510<br>Del:3FM00400110 |
| | | A | 3FM00418310 | CONN.M (S1315-04RWA-S03-KQDH,XINYA) | 1 | CN1 | 0 | |
| 7 | 2AAD539R13H | B | | | | | | 1st:3FM00418310<br>2nd:3FM00417510 |
| | | A | 3FM00418310 | CONN.M (S1315-04RWA-S03-KQDH,XINYA) | 1 | CN1 | 0 | |
| 8 | 2AAD5390031<br>2AAD5390131<br>2AAD6970031 | B | | | | | | 1st:2AAD539R13H<br>2nd:2AAD539R03H |
| | | A | 2AAD539R13H | Badge BD ASSY (RGT2422AMII) | 1 | | 0 | |

# ECR (Engineering Change Request)



**Engineering Change Assessment Item List**
**工程變更評估項目清單**

| Document | Confirm | Authorized Dept. | Remark |
|---|---|---|---|
| 1. Application for Revision of Specification or Drawing(s) for delivery<br>是否有修改交貨的規格或圖面 | ☐Yes ■No need | RD | 同等品 |
| 2. Standards or Regulatories Impact<br>是否有評估適用之標準或主管機關之相關法規的申請 | ☐Yes ☑No need | DQE | 沒影响 |
| 3. Change point of PCB mounting<br>PCBA插件位置是否變更 | ☐Yes ■No need | RD | |
| 4. PCBA Process Changes<br>PCBA製程是否變更 | ☐Yes (Continue checking below)<br>☑No | PE | |
| 4-1) Change of Reflow temperature<br>迴焊溫度是否變更 | ☐Yes ☐No need | | |
| 4-2) Change of bonding temperature<br>膠合溫度是否變更 | ☐Yes ☐No need | | |
| 4-3) Change of Manual Soldering temperature<br>人工手焊工具之溫度是否變更 | ☐Yes ☐No need | | |
| 4-4) Change of storage condition after protection humidity package<br>防潮包裝完成後的儲存條件是否變更 | ☐Yes ☐No need | | |
| 5. Reliability test report (Test result and data)<br>是否有可靠性測試報告（測試結果及數據） | ☐Yes ☑No need | DQE | 沒影响 |
| 6. Process FMEA（Medical only）<br>是否有進行製程失效模式與效應分析 | ☐Yes ☑No need | PE | 無影响 |
| 7. Design FMEA （Medical only）<br>是否有進行設計失效模式與效應分析 | ☐Yes ■No need | RD | 同等品 |
| 8. Risk Management（Medical only）<br>是否有進行風險管理評估 | ☐Yes ■No need | RD | 同等品 |
| 9. Change points due to the modification<br>是否此修改會延伸導致其他變更點 | ☐Yes ■No need | RD | |

# ECR (Engineering Change Request)



**Engineering Change Assessment Item List**
**工程變更評估項目清單**

| Document | Confirm | Authorized Dept. | Remark |
|---|---|---|---|
| 10. Initial Supply Control implements plan or result.<br>是否有實施供料控制評估 | ☑Yes ☐No need | PMC | |
| 10-1) Confirm the work order or order number or date for the implementation start of the engineering change.<br>確認工程變更開始實施之工單或訂單號碼或日期。 | ☑Yes ☐No need | | 2AAD539R13M 切換替代料 3FM00418310<br>(PO 4100049903) |
| 10-2) Coordinate the handling methods for related products and materials.<br>協調相關產品及材料處理方法。 | ☐Yes ☑No need | | 3FM00200110 已無庫存.<br>3FM00317510 Z6, 扣除在途乘1156pcs, 從價由 PO 4100049703 去化 2AAD539R238 |
| 10-3) Arrange the production schedule.<br>處理生產日程之安排。 | ☐Yes ☑No need | | 3FM00417510 已切量<br>3FM00400110 已無庫存 |
| 10-4) Control the changed materials.<br>變更材料之管制。 | ☐Yes ☑No need | | |
| 10-5) Establish relevant execution control records for EC materials, register traceability data for each material.<br>建立有關工程變更物料之相關執行管控記錄、登錄各項物料追溯性資料。 | ☑Yes ☐No need | | 系統管控. |
| 11. Training Requirement<br>若此一變更影響製程或檢驗，是否需要再做人員訓練 | ☐Yes ☑No need | PE | 無影响 |
| 12. Modification contents (For example, the following documents)<br>是否有評估此變更之各項相關文件（如下）<br>☑MDF ☐ DMR ☑ SOP ☐ SIP ☐ QC control plan ☐ Approval Sheet ☐ Engineering Spec<br>☐ Others | ☑Yes ☐No need | QA | |

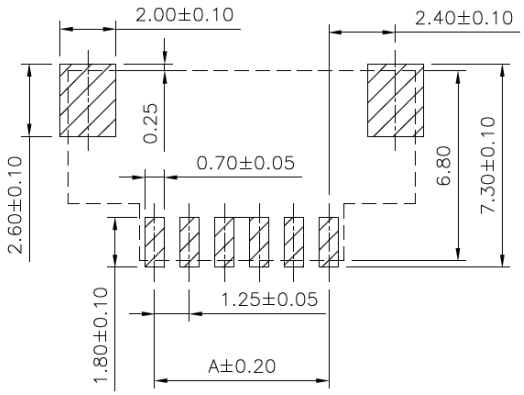
DIVA Labs.

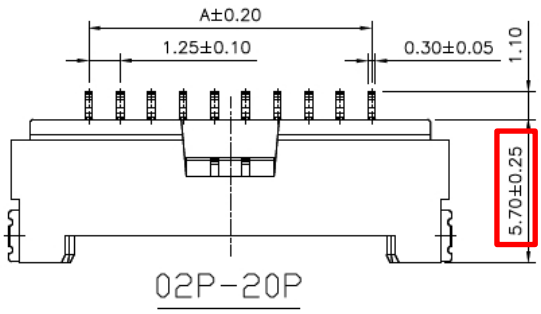
# Comparison Report

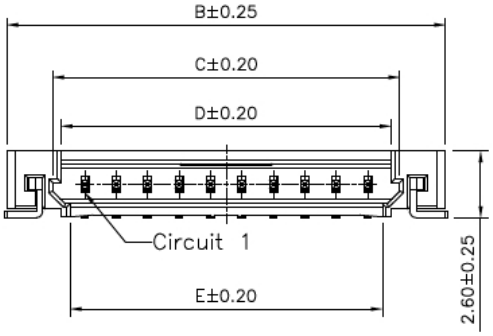
## 1. Package Dimension

| Item | Old<br>Superior(竣豪) | New<br>Xinya(新亞) |
|---|---|---|
| 2pin | **3FM00217510** | **3FM00218310** |
| 3pin | **3FM00317510** | **3FM00318310** |
| 4pin | **3FM00417510** | **3FM00418310** |
| Remark | | |

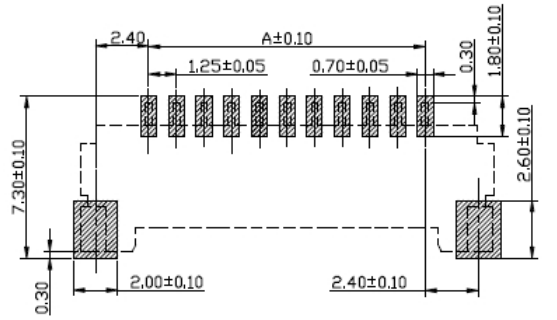
| Poles | Dimensions (mm) | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E |
| 2 | 1.25 | 7.45 | 3.81 | 3.13 | 2.43 |
| 3 | 2.50 | 8.70 | 5.06 | 4.38 | 3.68 |
| 4 | 3.75 | 9.95 | 6.31 | 5.63 | 4.93 |

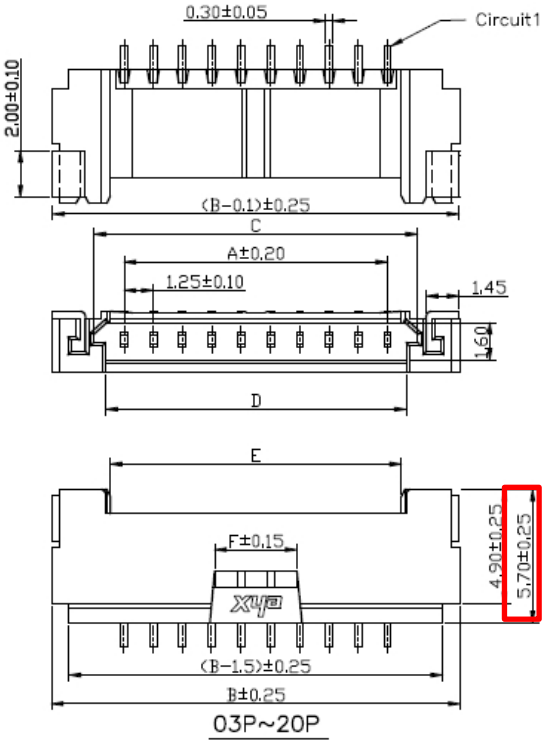


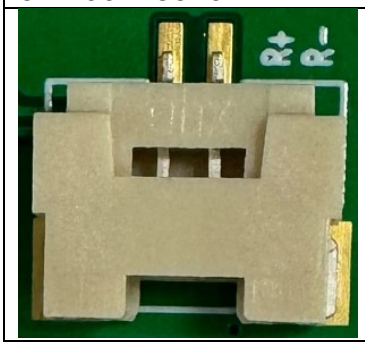
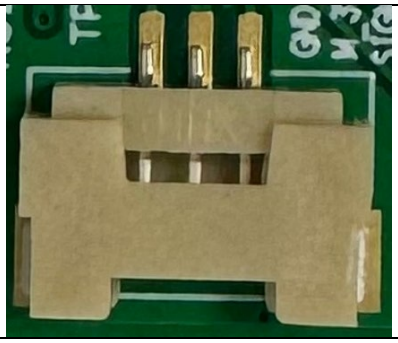
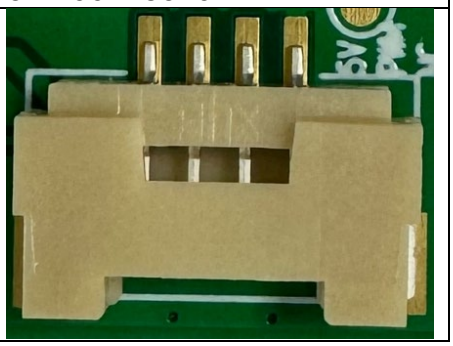




| No. of Contacts | DIMENSIONS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F |
| 2 | 1.25 | 7.45 | 3.81 | 2.83 | 2.43 | 3.50 |
| 3 | 2.50 | 8.70 | 5.06 | 4.08 | 3.68 | 3.50 |
| 4 | 3.75 | 9.95 | 6.31 | 5.33 | 4.93 | 3.50 |



# Comparison Report

| Xinya(新亚)<br>3FM00218310 | Xinya(新亚)<br>3FM00318310 | Xinya(新亚)<br>3FM00418310 |
|---|---|---|
|  |  |  |

鈺緯科技開發股份有限公司

# 設計變更審查會議記錄

| 會議名稱 | ECN/ECR | 日期 | 2025/12/01 | 時間 | 13:00-15:00 | 地點 | 800 會議室 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 會議種類 | 例會 | | | | | | |
| 主席 | Terry | 與會人員 | Ryan, Lily, Kevin, Terry, Hsuan, Oliver , Miu | | | | |
| 會議記錄 | Terry | 缺席人員 | 無 | | | | |

**主席指示事項：**

| No | 工作項目 | 負責人 |
|---|---|---|
| 1. | EPIQ Badge BD 增加 second source | Tony |
| 2. | EPIQ 機種內部 Connector 增加替代廠商 | Tony |

**決議事項：**

| No | 工作項目 | 負責人 | 狀態 |
|---|---|---|---|
| 1. | 發行 EC | Tony | |

**追蹤事項：**

| No | 工作項目 | 負責人 | 完成日期 | 狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 無 | | | | |

**會議記錄內容：***(XXX)紅色部分表示該事項負責人

變更號碼：

機種名稱: EPIQ 系列機種

設計變更原因：增加 2nd

設計變更描述: 同等品

導入時程 : Normal

客戶審查 : No Needed

一. 研發課評估:

| 單位 | 審查內容 | 附加文件 |
|---|---|---|
| EE : | 評估變更不會造成硬體安全性影響 | Comparison Table |
| FW: | 與 FW 設計無關,不會造成軟體安全性影響 | 無 |
| ME: | 變更處不影響 ME，並不會造成產品功能，性能及安全 | 無 |
| SW: | 與 SW 設計無關,不會造成軟體安全性影響 | 無 |
| DQE: | 此變更不會造成產品功能,性能及安全性影響,評估後無需進行相關驗證. | 安規部門評估: 無法規問題 |

二 結論:

1. 開發單位各部門評估後,此設計變更不會對產品預期用途造成影響,
   設計變更風險審查於風險評估報告中呈現

| | |
|---|---|
| 功能 | 設計變更內容無關功能影響 |
| 性能 | 設計變更內容,無關產品性能影響 |
| 可用性 | 無影響,沒有使用上的風險 |
| 安全性 | 組裝方式沒有改變, 沒有安全性風險, |
| 法規 | 經審查,沒有影響法規內容 |